

广州方邦电子股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称: 广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州穗邦电子有限公司（以下简称“穗邦电子”）拟通过自有资金向江苏上达半导体有限公司（以下简称“江苏上达”或“目标公司”）投资入股。

● 投资金额: 投资金额合计拟为人民币 1,500 万元，穗邦电子拟认购江苏上达以非公开形式发行的新股 725,200 股，持有目标公司 0.4975% 股权。

● 本次投资已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

● 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示:

1、研发及市场开拓风险

目标公司是国内主要的显示驱动 IC 覆晶薄膜封装基板（Chip On Flim，简称“COF”）供应商。COF 基板是显示驱动 IC 封装用之卷带式高密度引脚柔性封装基板，是平板显示产业链上游材料的重要一环，是生产半导体芯片所必须的关键材料之一，需要持续的研发攻关、产品迭代升级、下游测试及导入等一系列环节，技术壁垒高、研发投入较大、研发周期较长，因此存在不确定性。另外，研发成功后的产品仍需经过市场营销、客户开拓等市场化阶段。如目标公司最终不能成功研发出契合市场需求且具备成本优势的产品并持续迭代升级，可能导致目标公司竞争力下降，影响目标公司后续发展，

存在公司的投资不能收回的风险。

2、持续经营风险

目标公司主营业务为 COF 基板的研发、生产和销售，具备较强的人才密集、资金密集的特点，产品也需要不断更新迭代，提高性能，以适应不断发展的市场需求，因此持续性的研发投入及市场落地均需要大量的资金投入。目标公司后续如不能通过自身盈利或通过外部融资持续获取资金，将可能面临资金短缺、项目研发及市场开拓停滞等风险，影响目标公司的核心竞争力和可持续发展能力。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于战略规划考虑与业务发展需要，公司的全资子公司穗邦电子与江苏上达近日拟签署相关投资协议，穗邦电子拟以自有资金人民币 1,500 万元向江苏上达增资，增资后穗邦电子将持有目标公司 0.4975% 股权。

（二）对外投资的决策和审批程序

2024 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于子公司对外投资的议案》，全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）目标公司基本情况

公司名称：江苏上达半导体有限公司

注册资本：14503.9981 万元人民币

统一社会信用代码：91320382MA1PATMH4B

注册地址：邳州市经济开发区辽河路北侧、华山路西侧

法定代表人：李晓华

经营范围：高精密超薄柔性封装基板、大规模集成电路、电子元件的研发、

生产、销售及技术咨询、技术服务；卷带式柔性 IC 载板连接芯片、半导体材料及元器件的封装及测试；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

投资标的最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	131,754.58	130,361.79
负债总额	61,009.52	60,735.92
净资产	70,745.06	69,625.87
营业收入	23,326.68	15,273.07
净利润	-4,799.71	-2,939.58

截至本公告披露日，目标公司未被列入失信被执行人，与公司及公司控股股东和实际控制人、持有公司股份 5% 以上的其他股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系及利益安排，未直接或间接持有公司股份。

（二）目标公司的股权结构

根据《投资协议》，预计本次认购完成后，目标公司的注册资本为 14,576.5181 万元人民币，增资前后目标公司股权结构如下：

股东名称	增资前持股数 额（万股）	增资前持股 比例（%）	增资后持股数 额（万股）	增资后持股 比例（%）
深圳市鑫尚融电子有限公司	10,000.0000	68.9465%	10,000.0000	68.6035%
徐州尚融企业管理合伙企业 （有限合伙）	242.3158	1.6707%	242.3158	1.6624%
徐州博硕股权投资有限公司	1,288.0942	8.8810%	1,288.0942	8.8368%
广东粤澳半导体产业投资基金 （有限合伙）	968.5230	6.6776%	968.5230	6.6444%
金石制造业转型升级新材料 基金（有限合伙）	968.5230	6.6776%	968.5230	6.6444%
广州新星贰号股权投资合伙 企业（有限合伙）	193.7046	1.3355%	193.7046	1.3289%

股东名称	增资前持股数额（万股）	增资前持股比例（%）	增资后持股数额（万股）	增资后持股比例（%）
广州新星翰禧股权投资合伙企业（有限合伙）	193.7046	1.3355%	193.7046	1.3289%
广州市鼎森创业投资合伙企业（有限合伙）	169.4915	1.1686%	169.4915	1.1628%
北京屹唐长厚显示芯片创业投资中心(有限合伙)	96.8523	0.6678%	96.8523	0.6644%
广州穗邦电子有限公司			72.5200	0.4975%
嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）	29.0556	0.2003%	29.0556	0.1993%
嘉兴德宁宏阳二期股权投资合伙企业（有限合伙）	19.3704	0.1336%	19.3704	0.1329%
嘉兴德宁元皓股权投资合伙企业（有限合伙）	11.6222	0.0801%	11.6222	0.0797%
深圳市福田区中洲铁城创业投资企业（有限合伙）	38.7409	0.2671%	38.7409	0.2658%
王松	45.0000	0.3103%	45.0000	0.3087%
孙彬	45.0000	0.3103%	45.0000	0.3087%
沈靖	45.0000	0.3103%	45.0000	0.3087%
沈洪	45.0000	0.3103%	45.0000	0.3087%
周波	35.0000	0.2413%	35.0000	0.2401%
罗永安	30.0000	0.2068%	30.0000	0.2058%
于宁超	9.0000	0.0621%	9.0000	0.0617%
蔡道库	8.0000	0.0552%	8.0000	0.0549%
王健	8.0000	0.0552%	8.0000	0.0549%
杨洁	8.0000	0.0552%	8.0000	0.0549%
刘瑞	6.0000	0.0414%	6.0000	0.0412%
合计	14,503.9981	100.00%	14,576.5181	100.00%

三、出资方式

穗邦电子拟以自有资金人民币 1,500 万元向江苏上达增资，增资后穗邦电子将持有目标公司 0.4975% 股权。

四、对外投资合同的主要内容

（一）合同主体

目标公司：江苏上达半导体有限公司

投资人：广州穗邦电子有限公司

（二）合同主要条款

1、穗邦电子向目标公司投资 15,000,000.00 元，认购目标公司以非公开形式发行的新股 725,200 股。

2、在交割条件均成就的情况下，穗邦电子应于收到目标公司发出的《付款通知书》和相应变更文件后十个工作日内一次性将本次增资的认购价款支付至目标公司银行账户。

3、穗邦电子按照本协议的约定支付认购价款后即享有法律法规、投资协议和公司章程规定以及目标公司股东之间约定的与标的股份相关的所有股东权利和利益，包括但不限于：目标公司增资款支付日之前的实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润以及其他全部所有者权益，股东表决权、提名权等。

4、目标公司承诺在收到穗邦电子支付的认购价款后 5 日内向投资方提供目标公司盖公章的《出资证明书》，并在本轮增资关闭后 30 个工作日内完成本次增资的注册资本及股东、公司章程的工商变更登记、备案，并于完成此等工商变更登记备案后向投资方提供目标公司变更后的公司章程（复印件并加盖目标公司公章）、目标公司变更后的营业执照（复印件并加盖目标公司公章）、目标公司变更后的工商登记信息单（复印件并加盖目标公司公章）。

五、对外投资对上市公司的影响

公司本次增资江苏上达，是公司进一步完善和提升产业布局的举措，符合公司总体发展战略要求，对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国内主要的显示驱动 IC 覆晶薄膜封装基板（Chip On Flim，简称“COF”）供应商，2024 年产能达 60kk/月，主要服务硕中科技、通富微电、集创北方等国内知名 IC 设计公司和半导体封测公司。COF 基板是显示驱动 IC 封装用之卷带式高密度引脚柔性封装基板，是平板显示产业链上游材料的重要一环，是生产半导体芯片所必须的关键材料之一。当前全球 COF 技术、产能主要集中在韩国、台湾地区，随着高清显示行业快速发展，国内 COF 产能自给率严重不足，国产替代的需求形成了良好市场空间。

目标公司稳定量产 8 μ m 级单面 COF 基板，拥有核心知识产权，实现了材料、设备及药水的部分国产化，技术水平在国内处于先进水平，产品已实现产业化，具有较高的投资价值。

公司与目标公司的业务具有一定的协同性。COF 基板主要原材料之一为 FCCL（挠性覆铜板），公司目前已布局了 FCCL 业务，通过加强与目标公司的交流与合作，可有效加快公司极薄 FCCL 研发、测试认证及产业化进程，从而提升公司经营业绩和核心竞争力。

本次对外投资以公司自有资金投入，是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

1、研发及市场开拓风险

目标公司是国内主要的显示驱动 IC 覆晶薄膜封装基板（Chip On Flim，简称“COF”）供应商。COF 基板是显示驱动 IC 封装用之卷带式高密度引脚柔性封装基板，是平板显示产业链上游材料的重要一环，是生产半导体芯片所必须的关键材料之一，需要持续的研发攻关、产品迭代升级、下游测试及导入等一系列环节，技术壁垒高、研发投入较大、研发周期较长，因此存在不确定性。另外，研发成功后的产品仍需经过市场营销、客户开拓等市场化阶段。如目标公司最终不能成功研发出契合市场需求且具备成本优势的产品并持续迭代升级，可能导致目标公司竞争力下降，影响目标公司后续发展，存在公司的投资不能收回的风险。

2、持续经营风险

目标公司主营业务为 COF 基板的研发、生产和销售，具备较强的人才密集、资金密集的特点，产品也需要不断更新迭代，提高性能，以适应不断发展的市场需求，因此持续性的研发投入及市场落地均需要大量的资金投入。目标公司后续如不能通过自身盈利或通过外部融资持续获取资金，将可能面临资金短缺、项目研发及市场开拓停滞等风险，影响目标公司的核心竞争力和可持续发展能力。

公司将根据对外投资的后续进展情况，按照相关法律法规和的规定和《公司章程》的要求，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2024年9月19日